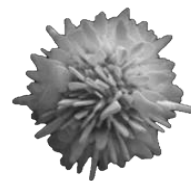


開発品

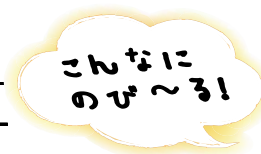
# インモールドエレクトロニクス用銀ペースト

- 3次元形状（インモールドエレクトロニクス等）に対応する新開発の伸縮導電性銀ペーストです。
- 化研テック独自の銀粉を配合。成形時の伸びに追従し、良好な導電性を発揮します。



## [特性値と使用条件]

項目	特性値
比抵抗	$2 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$
乾燥条件	60℃ 15分（塗膜厚による）
伸び率	20%以内を推奨
塗布方法	スクリーン印刷、メタルマスク印刷 ディスペンサー塗布



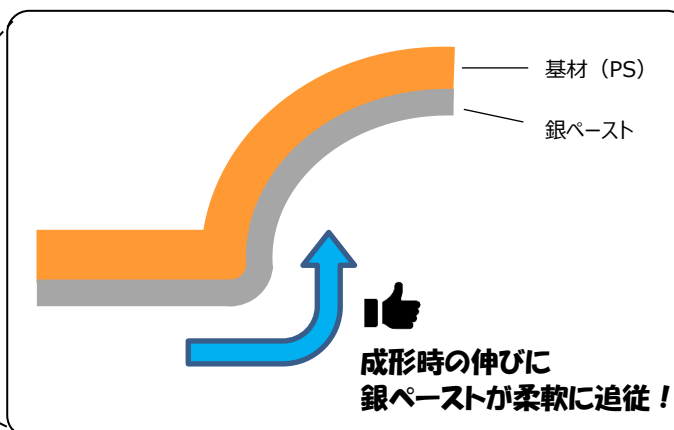
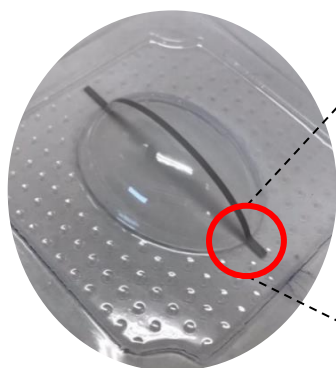
## [特長]

- フィルムや基材などの平版へ印刷後に、成形加工ができます。
- 銀ペーストは成形時の基材の伸びに追従して断線しません。
- ABSなどの汎用的な樹脂への密着性が良好です。
- 低温（60℃）で乾燥できるためPETフィルムなどにも使用できます。

## [想定される使用用途]

- シートインサート成形、インモールド成形、真空/圧空成形など

（制作例：真空成形）



スクリーン印刷でフィルム上に2次元配線形成



フィルムを立体成形し3次元配線へ



本説明書中のデータは、弊社の実施した評価結に基づいていますが、お客様のご使用時の製品特性を保証するものではありません。実際に使用される装置および被着材で十分ご検討の上、ご使用ください。